

# 行政院產學研連結會報第 11 次會議紀錄

壹、時間：112 年 8 月 9 日(星期三)上午 10 時

貳、地點：行政院第一會議室

參、主席：吳召集人政忠、林共同召集人萬億

肆、出席人員：如後附簽到表                      紀錄：余祐先、蘇玫君

伍、主席致詞：略

陸、報告事項：

一、秘書組：前次會報決議事項辦理情形(教育部)

決定：

(一) 洽悉。

(二) 解除列管議題計 3 件，請相關部會依會議決議持續推動辦理，並請主(協)辦機關加速推動時程。

二、人才培育鏈結組：

(一) 促進國家重點領域之國際合作(教育部)

決定：

1、洽悉。

2、教育部規劃推動「國家重點領域國際合作聯盟」，與美歐國家合作，有利於互惠培育人才，惟仍需保持警戒，避免他國吸收我國關鍵人才、技術。

3、因我國人力、資源有限，請教育部、國家科學及技術委員會(以下簡稱國科會)、國家發展委員會(以下簡稱國發會)等相關部會透過跨部會平臺密切合作，以國家整體戰略角度思考布局，規劃未來因應策略；必要時由龔政務委員明鑫及吳政務委員政忠召會研商。

## (二) 「全球 IC 設計訓練基地」推動規劃(國科會)

決定：

- 1、洽悉。
- 2、有關海外基地之課程開設及招生等籌劃事宜，涉及國際生來臺條件及攻讀學位等事項，請國科會會同教育部再予釐清。
- 3、國際生於我國企業海內外研發據點就業一節，考量各國就業規範有所不同，請國科會與經濟部(工業局)就攬才及產業介接等相關問題再行研議。
- 4、海外基地目前規劃以中東歐國家為主，未來可將東南亞國家納入規劃範圍，惟考量資源有限，需慎選納入之國家，請教育部提供相關資訊予國科會進行後續評估；並請國科會、教育部、數位發展部、國發會等加強跨部會合作，積極推動「晶創臺灣計畫」，透過我國半導體製造技術領先優勢吸引來臺落地，使臺灣成為全球 IC 設計的創新泉源與投資重鎮。

## (三) 113-116 全球攬才及一站式在地深耕服務計畫(國發會)

決定：

- 1、洽悉。
- 2、為延攬外籍人才來臺對接我國就業市場，請國發會會同外交部、教育部、經濟部、僑委會等相關部會積極推動，切實達成攬才目標。

柒、臨時動議：無

捌、散會。(上午 11 時 30 分)